

H 01 L 23/36

Ans.nr.: 2357/86

Indleveret: 21 maj 1986

Løbedag: 21 maj 1986

Alm. tilgængelig: 23 nov 1986

Prioritet: 22 maj 1985 DE 3518310

*SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG; Chippis, CH.

Opfinder: Uwe *Bock; DE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stelling ApS

Kølelegeme til halvlederkomponenter og fremgangsmåde til dets fremstilling

S A M M E N D R A G

2357-86

Et kølelegeme til halvlederkomponenter, især af strengpresset letmetal, med køleribber, som i indbyrdes afstand rækker ud fra en grundplade, og som har et stavagtigt tværsnit, samt en fremgangsmåde til fremstilling af dette skal muliggøre et stort ribbeforhold og dermed en fremstilling af et såkaldt højeffektkølelegeme.

Til dette formål er grundpladen (11) i overfladen (12) forsynet med hovednoter (14), i hvilke der fastholdes en køleribbe (20) med en sokkel (22). Sidstnævnte er anbragt formltilpasset i hovednoten (14) i grundpladen (11) fortrinsvis ved, at formltilpasningen mellem grundpladen (11) og køleribben (20) tilvejebringes dels ved mindst fra en notvæg (16) tildannet materialevulster (17), og dels sidenoter (24) i soklen (22), som optager disse.

2357-86

